国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026—046

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　　☐分析师会议 ☐媒体采访　　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　　☐路演活动 ☐现场参观　　☐电话会议 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	兴业证券：刘思仪 中信建投：顾辛迪 深湾汇研：崔乾林 工银瑞信：滕冠兴 华安证券：李庆录 上海胤胜：杨潇 上海碧水泉私募：陈静 华海资本：董承明 上海瀚伦投资：王柱峰 瀚鑫基金：梁纯杰 中信资管：程骥腾 招商证券：王超
时间	2026 年 11 月 19 日
地点	国机精工会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：赵祥功 投资者关系助理：汪智婷
投资者关系活动主要内容介绍	**1.问：公司是否有金刚石 PCD 钻针产品？** 答：公司拥有金刚石微钻产品，当前仅在航空碳纤维打孔领域实现应用，暂未布局半导体领域。 **2.问：人形机器人轴承业务前景如何？** 答：长期看，人形机器人轴承有望成长为轴承行业重要的细分子市场，成长空间巨大，短期来看，行业仍处于技术迭代升级期，能够规模化应用的时间节点尚不明朗。公司已将机器人轴承纳入“十五五”业务板块规划，未来重点聚焦交叉滚子轴承等高附加值产品。 **3.问：怎么看待公司轴承业务未来发展情况？**

	答：上半年轴承业务实现营业收入 8.15 亿元，同比下降 17.63%，主要受风电行业周期性变化影响。 航天特种轴承作为公司盈利的“压舱石”，传统优势地位持续稳固。产品全面覆盖卫星、运载火箭全系统关键部位，国内主流航天企业均为公司客户。可重复使用运载火箭方面，有力保障长征十号乙等国家重大航天工程任务顺利实施，配套朱雀三号重复使用遥二运载火箭完成发射与回收任务验证。随着商业航天进入常态化高频发射阶段，相关业务正逐步为公司带来新的增量。 **4.问：超硬材料磨具业务在半导体领域的开展情况？** 答：近几年，得益于我国半导体产业的发展，公司应用在半导体领域的产品保持较快增长势头，上半年同比增速约 40%，未来增长空间大。公司已形成“金刚石工具+精密陶瓷制品”的产品布局，覆盖倒边轮、减薄砂轮、划片刀、封装刀及陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等产品，贯穿半导体晶圆制造到封装测试全流程，客户覆盖国内主流晶圆厂、封测厂与设备厂商。 **5.问：公司金刚石工具业务的情况？** 答：公司在半导体领域金刚石工具产品上处于行业领先地位，主要包括划片刀、封装刀、减薄砂轮等产品，用于晶圆减薄、芯片划切与封装测试环节，是目前公司超硬磨具业务最核心的增长来源。该类产品与海外龙头仍存在差距，公司将持续加大技术研发投入，迭代优化提升产品性能。 **6.问：公司精密陶瓷制品业务的情况？** 答：公司在半导体领域精密陶瓷产品上处于行业领先地位，该类产品包括陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等。应用在半导体领域的精密陶瓷制品，技术开发难度大，产品技术壁垒较高，市场前景好，是公司未来几年重点推广的产品，公司将加快其市场导入，持续提升市场占有率。 **7.问：公司金刚石散热产品有哪些降本路径？** 答：首先，金刚石散热片的生长用电成本较高，公司的新疆哈密产业园规划用于合成金刚石，利用当地低价电能降低成本；其次，推进全产业链技术迭代，包括晶种片、设备、沉积工艺、加工环节的技术创新来进一步降低成本。第三，随着核心部件国产化推进，设备采购成本近年已有明显下降。
关于本次活动	否

是否涉及应披露重大信息的说明	
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无